



# 8440 HS

## 产品信息

用于集成电路片嵌入智能卡的热反应薄膜

## 产品描述

tesa HAF® 8440 是一款基于热塑型共聚酰胺的热反应型双面半透明胶带。

产品特点：

- 可实现可靠的芯片模块固定
- 适用于PVC、ABS及PC卡
- 在所有常见注入线上都具有良好的操作性
- 优秀的抗老化性
- 在组装后卡的上不可见

## 特点

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

## 应用

tesa HAF® 8440 设计用于芯片模块嵌入到智能卡中。

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |      |         |       |
|---------|------|---------|-------|
| • 基材    | 无    | • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| • 胶粘剂类型 | 共聚酰胺 | • 总厚度   | 40 µm |

## 属性/性能值

- |        |                      |
|--------|----------------------|
| • 粘接强度 | 12 N/mm <sup>2</sup> |
|--------|----------------------|

## 附加信息

技术参数推荐：

以下是所推荐的机器运行的参数。请注意，最佳工艺参数强烈取决于机器的类型，特别是卡身和芯片模块的材料以及客户的要求。

1. 预贴：

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08440>



# 8440 HS

## 产品信息

### 附加信息

在预贴过程中，胶带贴在模块带上。这个步骤可以在线或者离线进行。预贴过程不会影响胶带的存放寿命。预贴模块带可以保存和胶带一样的时间。

机器设定：

\*温度 130 – 140 °C

\*压力 2 - 3 bar

\*时间 2.5 m/min

2. 模块嵌入：

在模块嵌入过程中，预贴模块是模块带上模切件定位到卡腔内，然后加热永久固定到卡身里。这个步骤确切的操作取决于注入线的类型。现在，常用多步骤方式：

单步操作-机器设定

\*温度<sup>1</sup> 180 – 220 °C

\*压力 65-75 N/module

\*时间 1.5 s

多步骤操作（2次或以上加热贴合）-机器设定：

- 温度<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- 压力 65-75 N/module
- 时间 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

温度为在热压头内侧所测量而得。对不同材料推荐设定不同温度：

\*PVC 180 - 190 °C

\*ABS 180 - 190 °C

\*PC 200 - 220°C

芯片模块之外的其他应用，需使用不同的机器设定。

粘贴强度值是在标准实验室条件下获得（平均值）。这个值是每个生产批次检查下的测隙极限(材料: 铝蚀刻试验样品/粘合条件：温度=120°C，P =10bar; 时间 =8分钟)

存储条件依据tesa HAF®的存放条件。



# 8440 HS

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08440>